

THERMOCHIP

FICHA TÉCNICA RESUMEN

THERMOCHIP® PANEL TOH_15/XPS/19

FORMATO: 2,44 X 0,60 m. MH



PANEL THERMOCHIP

PANEL THERMOCHIP	e total (mm)	RT (m2K/W)	U (W/m2K)	Peso (kg/m2)	Peso (kg/panel)	*3 apoyos L=1220		*4 apoyos L=813	*5 apoyos L=610
						Carga max. (kg/m2)	Carga a L=200 (kg/m2)	Carga a L=200 (kg/m2)	Carga a L=200 (kg/m2)
TOH/15-40-19_XPS 40mm	74,00	1,51	0,66	21,23	31,08	>909,00	>231,00	500,00	665,00
TOH/15-50-19_XPS 50mm	84,00	1,81	0,55	21,55	31,55	>1033,00	>263,00	625,00	830,00
TOH/15-60-19_XPS 60mm	94,00	2,01	0,50	21,87	32,02	>1212,00	>309,00	750,00	1000,00
TOH/15-80-19_XPS 80mm	114,00	2,58	0,39	22,51	32,95	>1453,00	>370,00	1000,00	1330,00
TOH/15-100-19_XPS 100mm	134,00	3,00	0,33	23,15	33,89	>1708,00	>435,00	1100,00	1410,00
TOH/15-120-19_XPS 120mm	154,00	3,72	0,27	23,79	34,83	>1853,00	>472,00	>1100,00	>1410,00
TOH/15-140-19_XPS 140mm	174,00	4,30	0,23	24,43	35,77	>1973,00	>503,00	>1100,00	>1410,00
TOH/15-160-19_XPS 160mm	194,00	4,87	0,21	25,07	36,70	>1973,00	>503,00	>1100,00	>1410,00
TOH/15-200-19_XPS 200mm	234,00	5,70	0,18	26,35	38,58	>1973,00	>503,00	>1100,00	>1410,00

*Resistencia mecánica, cargas positivas en apoyos. L en mm

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

Tablero exterior - Aglomerado hidrófugo

Espesor	e (mm)	19							
Conductividad térmica	λD (W/(m·K))	0,13							
Densidad	D (kg/m3)	600							
Difusión al vapor de agua	μ	20							
Calor específico	Ce [J/(kg·K)]	1700							

Núcleo aislante - XPS

Espesor	e (mm)	40	50	60	80	100	120	140	160	200
Conductividad térmica	λD (W/(m·K))	0,033	0,033	0,035	0,035	0,037	0,035	0,035	0,035	0,037
Densidad	D (kg/m3)	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Difusión al vapor de agua	μ	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Calor específico	Ce [J/(kg·K)]	1.450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450

Tablero interior - OSB3

Espesor	e (mm)	15							
Conductividad térmica	λD (W/(m·K))	0,1							
Densidad	D (kg/m3)	570							
Difusión al vapor de agua	μ	13							
Calor específico	Ce [J/(kg·K)]	1700							